

# エレクトロニクス部会ニュース

Vol. 10, No. 3 (通巻No. 60) 2018年8月6日

化学工学会エレクトロニクス部会ニュースをお届けします。内容は、平成30年度第3回幹事会のトピックです。

**【ご案内】** 幹事会後半には、各界の識者を招いて幹事会講演会を開催しています。これまでも希望があれば部会員の皆様の参加を受け付けていましたが、18年度から、より多くの部会員に参加いただくべく、事前に案内を流すことになりました。皆様のご参加をお待ちしています。

## ■ 2018 年度第 3 回幹事会トピック

- ・日時 平成 30 年 (2018 年) 8 月 1 日(水) 14:00~17:20
- ・場所 住友ベークライト株式会社本社 20 階 (天王洲パークサイドビル)
- ・出席者 近藤部会長, 横沢副部会長, 鳥成, 所, 嘉田, 薦田, 高木, 武野  
及川, 吉野 各幹事の 10 名 (敬称略)
- ・議事進行 鳥成幹事

### 1. 前回 (6/5) 幹事会議事録の承認

### 2. 会員異動, 幹事名簿確認

- ・退任する中村監事の後任として、荻野幹事 (京都大 名誉教授) の就任が了承されました。
- ・法人会員の異動について 日立化成株式会社の今年度末での退会の報告が有り, 了承されました。  
(同社の法人会員資格・法人会員特典は, 2019 年 3 月末まで継続します)

### 3. 会計報告

- ・平成 30 年 (2018 年) 度 6 月~7 月度の会計報告があり, 承認されました。詳細は資料 1 をご参照ください。

### 4. 平成 30 年 (2018 年) 度第 1 回エレクトロニクス部会シンポジウムについて

テーマ パワーデバイスと実装材料の進歩  
開催日 2018 年 8 月 22 日 (水) 13:00 (受付 12:30~)  
場所 東京工業大学 蔵前会館ロイヤルブルーホール

- ・準備の進捗や, 申し込み状況の報告がありました。
- ・当日の運営手順確認や役割の割り当てを行いました。
- ・今後申込み者への事前案内と, 参加者募集のリマインダメールの配信を行います。周囲の方にも, 是非ともご案内の上, 多数の参加をお待ちしております。

### 5. 平成 30 年度第 2 回シンポジウムについて

本年度第 2 回目のエレクトロニクスシンポジウムを下記要領で開催することとなりました。

◇第 2 回シンポジウム開催概要 (詳細は後日ご案内します)

- ・テーマ 高密度基板の微細化技術 ~レーザからフォトビアへ~
- ・日時 2018 年 11 月 2 日 (金) 午後 (12:00 受付開始, 12:30 開会で調整中)
- ・会場 大阪科学技術センター (大阪市西区靱本町 1-8-4)
- ・内容 露光装置, 露光技術, 高密度基板設計のための CAD ツール,  
感光性樹脂材料, フォトビア用めっき技術に関する講演を予定
- ・オーガナイザ 近藤部会長, 武野幹事

## 6. Mate2019 共催について

前年に続き、Mate2019（エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術，2019/1/29-30 開催）の共催依頼が主催者からあり，幹事会で承認されました。

## 7. APCChE2019（アジア太平洋化学工学連合会議）でのセッション開催について

エレクトロニクス材料とプロセスに関するシンポジウムを計画し，事務局に申込みを行いました。今後，海外招待講演を含む講演者の選定をすすめます。

## 8. 次回幹事会及び幹事会講演会

日時 2018年10月19日（金）

場所 住友ベークライト株式会社本社 20階会議室

進行役 横沢幹事

講演会 未定（幹事会の議題が多いため，開催しない場合有り）

### ■8/1 幹事会講演会概要

講師 三次元半導体研究センター 野北副センター長，齋藤主任

題目 三次元半導体研究センター C SIPOS の活動紹介

三次元半導体研究センターは，福岡県の「シリコンシーベルト福岡プロジェクト」の一環として，企業や研究機関の半導体に関する研究開発を総合的に支援する目的で平成23年に開所された。C SIPOSは，顧客企業の抱える課題に対してセンター内部の技術を提供し，顧客の事前検討に要する負荷を低減するプラットフォームであり，利用機関に設備や場所を提供して，先端半導体の設計から試作・実装，評価までを一貫して支援する体制を整えている。講演では，同センターのコア技術として①コア内蔵型部品内蔵基板のパワーデバイスへの適用，②再配線層の微細化（ $L/S < 1/1 \mu\text{m}$ ， $A/R > 2$ ）実用化のための感光マイクロビアやはんだレスでの固相拡散バンプ技術，③次世代インタポーザとしてのガラス基板開発，④プリント基板材料の高周波適用について重点的な解説があった。

★幹事会講演会は，部会員各位に聴講いただけます。詳しくは，次回幹事会の2週間程度前に配信される案内をご参照ください。

■資料 1

平成30年（2018年）6月～7月会計報告

1. 前回残高（平成30年5月末）

口座残高	<u>2,344,981</u> 円 ①
積立金	<u>1,800,000</u> 円
実質残高	<u>544,981</u> 円

2. 今回収入と支出

項目	日時	内容	金額 (円)
収入	2018/6/5	第2回幹事会 技術交流会費 (@3k×7)	21,000
	2018/6/29	年会費(法人) @50k×1社 (入金確認済み分)	50,000
	2018/7/31	部会交付金 (化学工学会より)	100,000
<b>収入計</b>			<b>171,000</b> ②
支出	2018/6/5	第2回幹事会 開催費	4,000
	2018/6/5	技術交流会開催費	31,000
	2018/6/12	幹事会講演会 諸謝金・交通費 (KRI松田様)	49,352
	2018/6/12	幹事会交通費	77,580
<b>支出計</b>			<b>161,932</b> ③
月次収支			9,068 ②-③
全体収支 ①+②-③			<b>2,354,049</b> ④

3. 残高（平成30年7月末）

口座残高	<u>2,354,049</u> 円 ⑤
積立金	<u>1,800,000</u> 円
実質残高	<u>554,049</u> 円

④の全体収支と、⑤の口座残高（平成30年5月末現在）が一致していることが確認された。